

NEWS RELEASE

報道資料

2010年7月16日

(日本時間)

アプライド マテリアルズ 電子デバイスの未来を支える各種イノベーションを紹介
今週サンフランシスコで開催のイベントで

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、会長兼 CEO マイケル・スプリンター) は 7 月 13 日 (現地時間)、サンフランシスコで今週開催の Semicon West 2010、Intersolar North America、ASMC の各イベントにおいて、未来世代のマイクロチップとクリーンエネルギーソリューションに向けた先進的なイノベーションを紹介すると発表しました。今回のテーマ "Turning Innovations into Industries" は、アプライド マテリアルズがこれまで積み上げてきたものと将来への約束を簡潔に表現したものです。アプライド マテリアルズは、たゆまぬ革新によりテクノロジーを事業チャンスに、技術向上をお客様や消費者の便益に転換し、産業の発展を支えています。

アプライド マテリアルズは、Semicon West 2010 において、スマートフォンやタブレット PC などのネットワークモバイル機器用に需要が高まっている高性能・高機能チップ用の新しい半導体製造技術を発表します。半導体向けメタル成膜装置の業界標準として定評を得ている Endura の発売 20 周年を機に、アプライドは Endura を使って次世代のメモリやマイクロプロセッサを製造するための重要なイノベーションを発表します。また、デバイスを微細化してより高密度で省エネ性の高い半導体を実現する画期的なエッチング技術も紹介する予定です。この技術はすでにお客様から大きな関心を集めています。

新しいコンシューマー製品はより小型で高性能が求められることから、三次元 IC と呼ばれる新たなチップパッケージング技術が台頭しつつあります。より少ない面積で優れた機能を発揮するこの三次元 IC は、複数の半導体を積層し、これを Si 貫通ビア (TSV) 構造によって相互接続するものです。アプライド マテリアルズは、TSV 生産に必要な装置のラインアップをとりそろえ、TSV の量産化を推進します。

アプライド マテリアルズは、併催される各種セミナーにおいて、最近の活動や、クリーンエネルギー関連で注目をしている太陽電池や LED 照明などの分野に関する講演を行う予定です。従来の電子デバイスに見られたような劇的なコストダウンをクリーンテクノロジー産業でも実現するには、アプライド マテリアルズをはじめ各企業が製造技術イノベーションを集中的に行っていく必要があります。

今年の Semicon West 等におけるアプライド マテリアルズの活動については、当社の Semicon/Intersolar/ASMC 2010 サイト (<http://www.semiwestapplied.com>) をご参照ください。マルチメディアリソースを提供するこのサイトには、製品情報、セミナースケジュール、その他イベントへのリンクが設けられています。

アプライド マテリアルズは、半導体チップ、フラットパネル、太陽電池、フレキシブルエレクトロニクス、省エネガラスの製造におけるイノベティブな装置、サービスおよびソフトウェア製品を幅広く提供する Nanomanufacturing Technology™ ソリューションのグローバルリーダーです。アプライド マテリアルズは、人々のライフスタイルを向上させるナノマニュファクチャリングテクノロジーを提供します。

詳しい情報はホームページ：<http://www.appliedmaterials.com> でもご覧いただけます。

このリリースは 7 月 13 日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:渡辺徹)は 1979 年 10 月に設立。京都支店ほか 10 のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社

社長室: 大橋 百合 (Tel: 03-6812-6801)

ホームページ: <http://www.appliedmaterials.com>
